

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

湖南宇晶机器股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：20260513

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	兴证全球基金、鹏华基金、广发基金、平安基金、新融资本、泉果基金、信诚基金、中信证券、天风证券
活动时间	2026年5月13日
活动地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：杨宇红 副总经理、董事会秘书：周波评 副总经理：李红春 证券事务代表：刘托夫
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 公司基本情况介绍</p> <p>湖南宇晶机器股份有限公司成立于1998年，是一家专注于硬脆材料精密加工机床制造的科技型企业。公司致力于为半导体、消费电子、光伏新能源等行业提供智能化装备解决方案，在国内多线切割机、研磨抛光机等生产及研发领域处于领先地位。</p> <p>公司主营业务涵盖硬脆材料加工设备、金刚石线、热场系统及光伏硅片系列产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于太阳能光伏硅片、手机触摸屏及后盖、磁性材料、蓝宝石、视窗玻璃、大理石等硬脆材料的精密加工，并为客户提供高效、精准的加工解决方案。</p>

二、投资者提出的问题及公司回复情况

问题一、消费电子行业的手机头部终端客户未来上市的手机拟采用3D玻璃曲面屏，会对公司设备带来哪些新的需求？

回答：公司生产的研磨抛光机适用于手机产品中玻璃、蓝宝石等硬脆材料的精密加工，手机头部终端客户未来采用3D玻璃面板的新工艺，预计会对公司生产的数控抛光机、曲面抛光机和四周抛光机带来较大的需求。

问题二、公司在半导体碳化硅材料、12英寸大硅片加工设备业务情况如何？

回答：1、公司的生产的8英寸碳化硅材料的切片设备已实现批量销售，并积极推进12英寸碳化硅材料切片设备的研制进度。2、公司研发的12英寸大硅片的专用切割设备已在公司内部验证一段时间，下一步将发往客户端现场进行验证。

问题三、公司在磷化铟材料的切割设备进展情况如何？

回答：公司根据磷化铟材料的特性研发了专用多线切割设备，采用金刚石线切割技术，线径更小、出片率更高，关键模组在行业内具有领先优势，目前设备研发及验证的进展顺利。

问题四、公司的光伏切割设备具体情况如何？

回答：受光伏行业整体阶段性供需失衡和竞争持续加剧的影响，目前国内光伏市场对切片设备的需求量较小，但海外市场对切片设备的需求依然增长，公司近两年海外业务拓展顺利，为未来持续开拓海外市场奠定了良好的基础。

问题五：关注到公司子公司有碳碳热场产品，目前这一块的业务有什么新的变化？

回答：公司子公司之前主要生产应用于光伏行业中的碳碳热场产品，受光伏行业景气度下降的影响此类业务规模较小，公司子公司现已

	<p>研发了碳陶刹车片产品，拓展了新的应用领域，实现业务转型升级，目前新业务进展顺利。</p> <p>问题六、公司未来的发展战略是什么？</p> <p>回答：公司将聚焦优势核心业务、优化整合部分业务，积极布局新兴产业，推进产品升级迭代及进口替代进程，加快业务全球化战略布局，努力提升公司综合发展水平和经营业绩，实现公司高质量可持续发展。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2026年5月13日